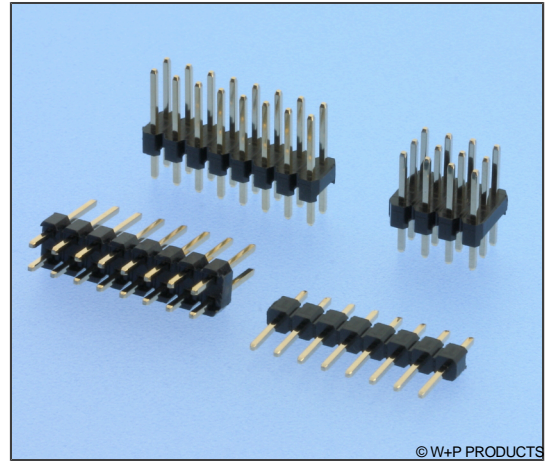


943 / 944 / 945

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows

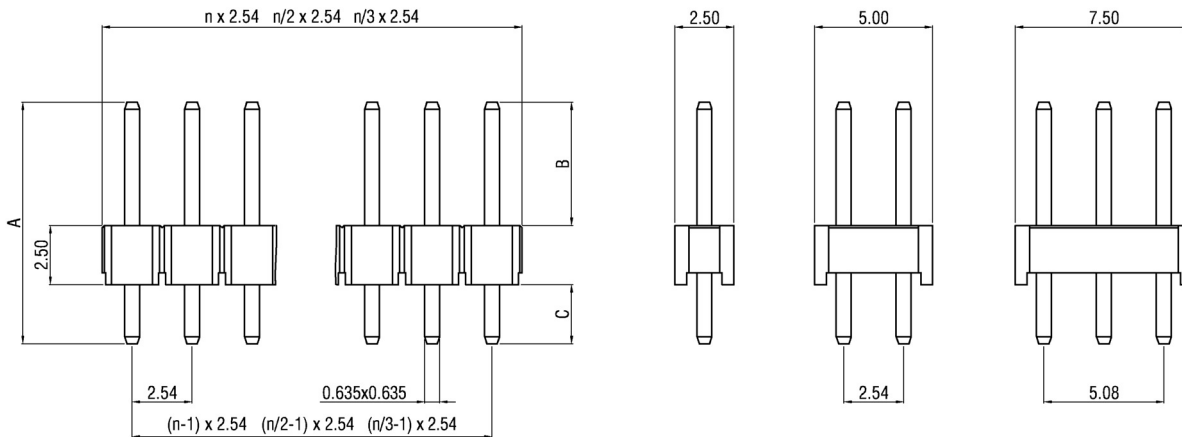
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c <i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i>	keine <i>none</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC <i>1 kV DC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC <i>250 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C <i>-40 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*

944

Gestanzte/geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts
943 Einreihig
Single row
944 Zweireihig
Double row
945 Dreireihig
Triple row

Dimensions*

10

10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm
11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm
12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm
13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm
14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm
15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm
16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm
17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm
18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm
19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm
20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm
A/B/C Gesamtlänge & Wunschmaße
Total length & Dimensions

Contacts*

010

001-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row
009-120 Dreireihig
Triple row

Plating*

00

00 Au flash
110 Sel. Au 0,25µm / Au flash
130 Sel. Au 0,75µm / Au flash
50 Sn
66 Sel. Au flash / Sn
610 Sel. Au 0,25µm / Sn
80 Sel. Au 0,75µm / Sn
Au flash ≤ 0,1µm
Au flash ≤ 0,1µm

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter
Techn. Informationen.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

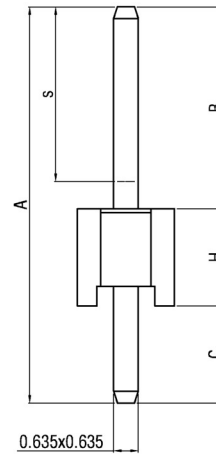
Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P (+49) 5223 98507-0
WE CONNECT IT sales@wppro.com

Gerade Stiftleisten

- A : Gesamtstiftlänge
- B : Länge Steckseite
- C : Länge Lötseite
- H : Höhe Isolierkörper
- s : Bereich der sel. Veredelung

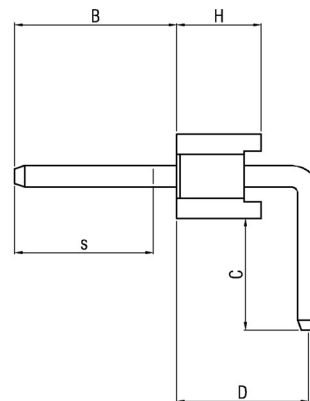
Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



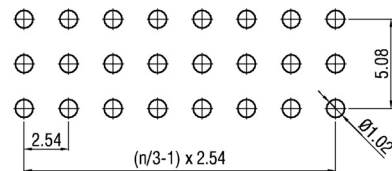
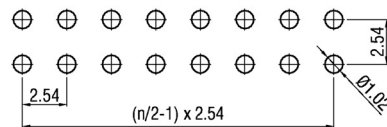
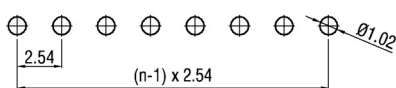
Gewinkelte Stiftleisten

- B : Länge Steckseite
- C : Länge Lötseite
- D : Abstand zu Steckseite
- H : Höhe Isolierkörper
- s : Bereich der sel. Veredelung

Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



PCB Layouts



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

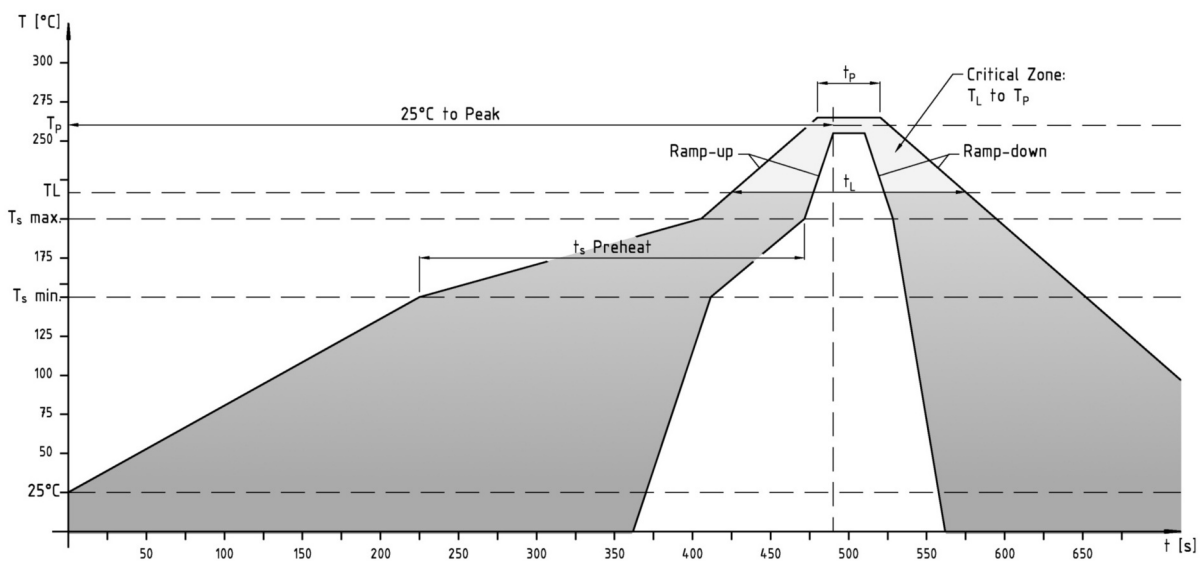
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min



Informationen zum Wellen-Lötverfahren

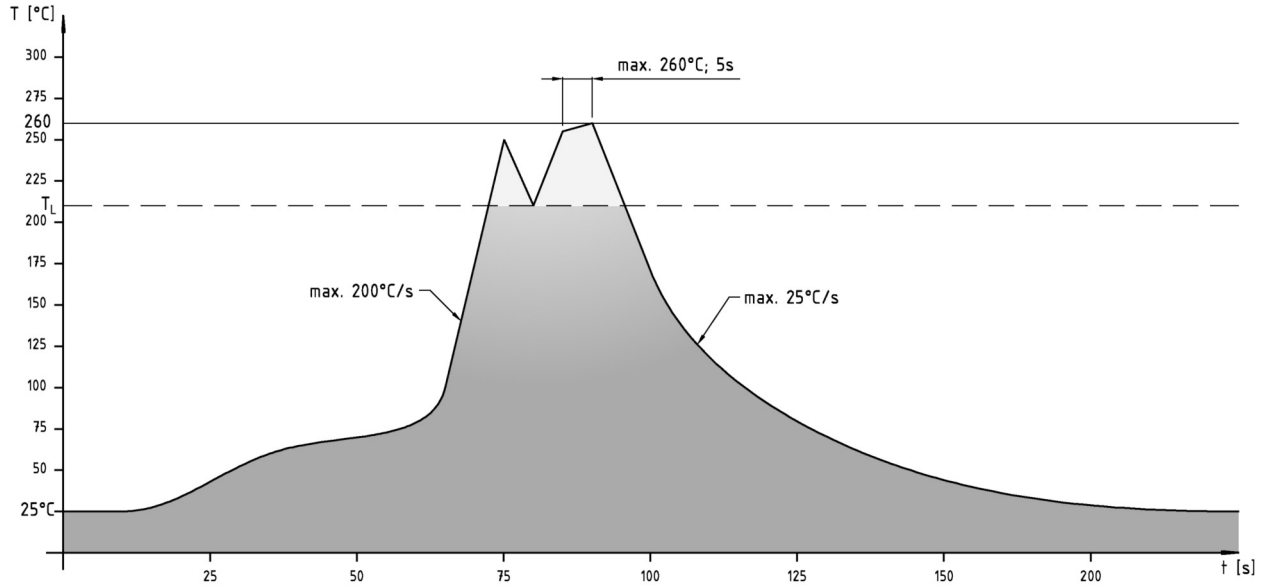
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

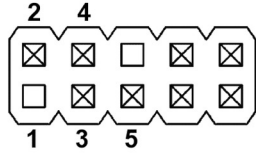
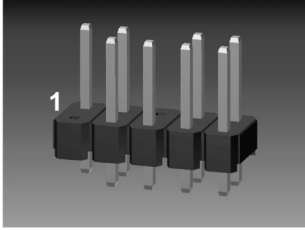
Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

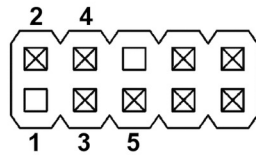
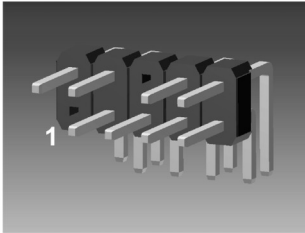
Empfohlenes Wellenlötprofil:



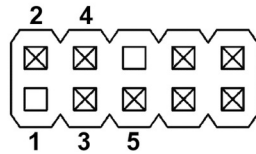
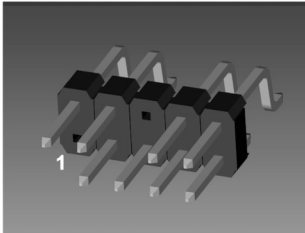
**Gerade Stiftheilen, Sandwich-Stiftheilen,
SMT-Stiftheilen stehend - 1-, 2-, 3-reihig**
*Straight Pin Headers, Dual Body Pin Headers,
Vertical SMT Pin Headers - Single, Double, Triple Row*



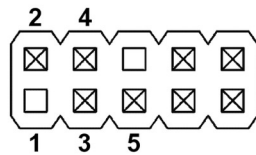
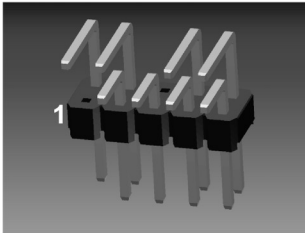
Gewinkelte Stiftheilen 1-, 2-, 3-reihig
Right-angled Pin Headers Single, Double, Triple Row



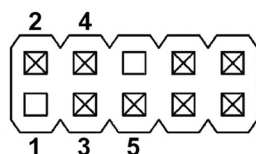
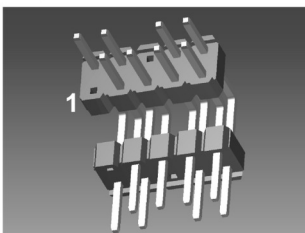
Liegende SMT-Stiftheilen 1-, 2-reihig
Horizontal SMT Pin Headers, Single, Double Row



Steckseitig gewinkelte Stiftheilen 1-, 2-reihig
*Right-angled Mating Side Pin Headers
Single, Double Row*



Gewinkelte Sandwich-Stiftheilen 1-, 2-, 3-reihig
*Right-angled Dual Body Pin Headers
Single, Double, Triple Row*



Serie / Bestellcode

Series / Order Code

Bestückungsschema

Assembly Pattern

bestückt / assembled

unbestückt / empty

3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 150

2 1

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 100

1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 50

1